

COMPANY RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

|| 企業調査レポート ||

筑波精工

6596 東証 TOKYO PRO Market

[企業情報はこちら >>>](#)

2025 年 6 月 12 日 (木)

執筆：客員アナリスト

寺島 昇

FISCO Ltd. Analyst **Noboru Terashima**



FISCO Ltd.

<https://www.fisco.co.jp>

目次

■ 要約	01
1. 会社の沿革と主な事業内容	01
2. 2025年3月期の業績(実績)	01
3. 2026年3月期の業績予想	01
4. 中長期の展望：EV車の長航続距離化は追い風、新たにAI半導体向けが立ち上がる	02
■ 会社概要	03
1. 会社概要	03
2. 沿革	03
■ 事業概要	04
1. 主要事業	04
2. 製品別概要	05
3. 半導体業界の動向	07
4. 主な顧客と需要	09
5. 同社の生産能力と特許政策及び競合	09
■ 業績動向	10
1. 2025年3月期の業績概要	10
2. 財務状況	11
■ 今後の見通し	12
■ 中長期の展望	13
1. EV車の今後の課題(航続距離)と解決策	13
2. 潜在市場の推測	14
3. もう1つの潜在市場(MOSFET用)とIGBTの広がり	15
4. AI半導体向け	15
■ 株主還元策	15

要約

電気自動車 (EV 車) の普及は追い風だが、足元は停滞。 新たに AI 半導体向け需要が立ち上がる

筑波精工 <6596> の主力事業は、電界による吸着保持技術を生かした静電吸着システム「静電チャック (E-Chuck)」(以下、静電チャック) である。国際特許を保有している高度な技術でありながら、過去においてはあまり多くの需要が期待されていなかったが、ここ数年で同社を取り巻く環境は変わりつつある。自動車の電気化 (EV 化) が急速に進む現在、航続距離をさらに長くすることが大きな課題となっているが、これを克服するために、搭載されるパワー半導体の薄型化が重要となってきたからだ。薄型半導体の製造プロセスで使用される同社の静電チャックに注目が集まっている。現在の売上高はまだ少額だが、自動車の EV 化が一段と進むなかで、今後の動向が注目される。加えて 2024 年からは AI 半導体向けにも需要が立ち上がりつつある。

1. 会社の沿革と主な事業内容

同社は、電気機械器具の製造販売並びに電気機械器具の検査、測定、治工具及び金型の販売を目的として、1985 年に栃木県真岡市熊倉町で設立した。設立当初は三洋電機 (株) の半導体の後工程関係の設備を設計・販売していたが、並行して社内でも開発を進めてきた静電チャックの開発に目途が付いたことから、2002 年からは静電チャックの研究開発と静電チャック関連製品の販売に絞って事業を展開し、2018 年に東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場した。

2. 2025 年 3 月期の業績 (実績)

2025 年 3 月期の業績は、売上高は 237 百万円 (前期比 27.2% 減)、営業損失は 44 百万円 (前期は 6 百万円の損失)、経常損失は 45 百万円 (同 7 百万円の損失)、当期純損失 69 百万円 (同 30 百万円の利益) ※となった。2024 年は自動車の EV 化が予想より停滞したことから、主要顧客の設備投資が低迷し、同社の売上高も減少した。手元の現金及び預金は 278 百万円と売上規模に比べて豊富であり、財務上の不安はない。純資産も現時点では 186 百万円となっているが、このままの停滞が続くと債務超過の恐れもあり、今後の動向は注視する必要があるようだ。

※ 前期は、デモ用機器の販売により特別利益 59 百万円を計上したことにより当期純利益を計上した。

3. 2026 年 3 月期の業績予想

2026 年 3 月期の業績は、売上高は 351 百万円 (前期比 47.8% 増)、営業利益は 4 百万円 (前期は 44 百万円の損失)、経常利益は 3 百万円 (同 45 百万円の損失)、当期純利益は 1 百万円 (同 69 百万円の損失) と予想している。前期は EV 向け需要が停滞したが、底打ちの気配は出ており 2025 年 4 月には「Supporter® (以下、Supporter)」と「自動機」で約 59 百万円を受注済みだ。さらに新たに AI 半導体向けの需要が立ち上がり始めており、期中に海外大手ファウンドリ向けの受注が期待できそうだ。今後は EV 向け需要に加えて、AI 半導体向けを含めて、量産用の需要が一気に高まる可能性があり、同社の「Supporter」の動向は注視する必要がある。

要約

4. 中長期の展望：EV車の長航続距離化は追い風、新たにAI半導体向けが立ち上がる

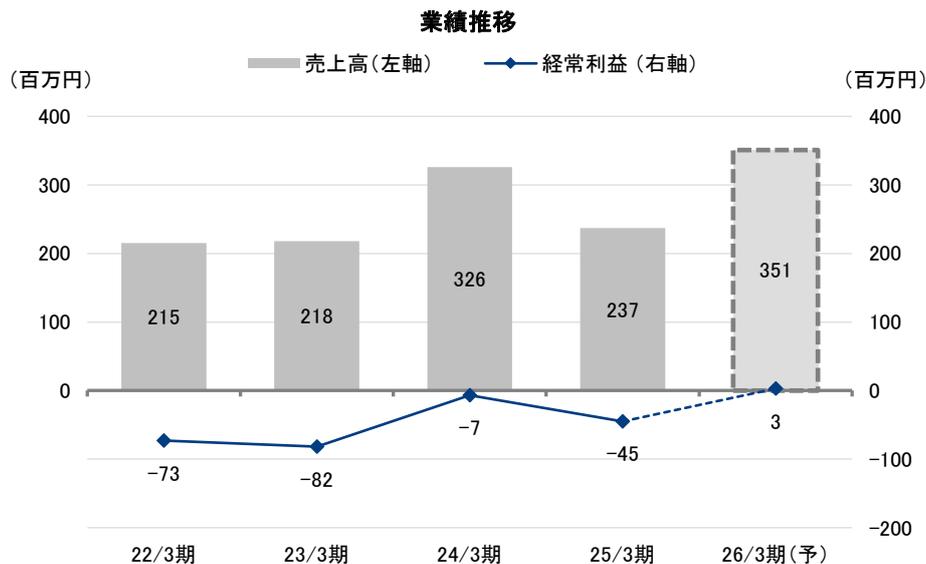
同社の今後の成長マップは、自動車のEV化のさらなる進展→長航続距離化が必須→IGBT※1等のパワー半導体の薄型シリコンウエハ（以下、ウエハ）での生産の必要性から「Supporter」の需要増となる。今までの需要は主に試験用であったことから、現在まで業績は低迷していた。しかし2024年3月期に初めて量産用の「自動機」を販売し、今後は自動車のEV化・長航続距離化に伴うパワー半導体のさらなる薄型化が見込まれるため、将来は明るいと言える。顧客側は12インチプロセスの増強を進めているが、今のところ12インチの静電チャックでは、同社製品に対する競合は見当たらないため、12インチウエハによるパワー半導体の薄型シリコンウエハの生産が本格化すれば、同社製品への需要がさらに増加する可能性がある。またEV自動車用の需要以外にも、携帯電話向けや自動車向けの高速バッテリーチャージャーの需要も増加しており、その必須部品であるMOSFET※2半導体の生産工程においても同社製品が使われる可能性が高い。さらに最近では、AI半導体の歩留まり向上のために同社の静電チャック方式が着目されており、新たな需要が期待できそうだ。

※1 IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor: 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ) は、パワー半導体 (より高い電圧、より大きな電流のコントロールを可能にする) の一種である。用途としては、“電気で動き、パワーの強弱を調整できるもの”で、電車や自動車 (ハイブリッド車 (HEV) やEV)、IHをはじめとする家庭調理機器やエアコン、冷蔵庫、洗濯機などがある。

※2 MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor: 絶縁ゲート電界効果トランジスタ) は、スイッチデバイス的一种。スイッチデバイスは電源を入れることで様々な機能を動かすための装置へ電力を供給する。その際に、入力電圧を各所出力電圧へ変換して電力供給する必要がある。例えば、パソコンであれば、液晶パネル、CPU、メモリやオーディオアンプ、USBコネクタなどを動かすために、MOSFETが入力電圧を変換し、電力を供給する。スイッチデバイスのなかでもMOSFETは、電力を高効率に流し、低消費電力に優れ、製品の小型軽量化を可能にするものである。

Key Points

- ・電界を用いた吸着システム静電チャックが主力事業。自動車のEV化で要注目
- ・2025年3月期はEV市場の停滞で営業損失だったが、2026年3月期は回復見込み
- ・中長期では、EV車の長航続距離化の恩恵を受けるが、新たにAI半導体向けも立ち上がる



出所：決算短信よりフィスコ作成

筑波精工

6596 東証 TOKYO PRO Market

2025 年 6 月 12 日 (木)

<https://tsukubaseiko.co.jp/ir/>

■ 会社概要

主力事業は電界を使った静電チャックで、EV 向けに成長を見込む。 新たに AI 半導体向けにも期待

1. 会社概要

同社は、静電チャックの開発・製造・販売を行う研究開発型の企業である。同社が自社開発を行ってきた静電チャックの特色は、対象物に電荷を与えることなく低電圧で高吸着力を発生するとともに、コードレスで薄い Carrier 型静電チャック「Supporter」を実現したことにある。そのため、既存の静電チャックでは取り扱えなかった素材（例えば極薄ウエハ等）が同社の事業対象に含まれるようになった。フラットパネルディスプレイのガラスの大型化やウエハの極薄型化など技術の高度化により、他社の静電チャックでは対応が困難な分野に事業が拡大している。

特に近年は EV の出荷台数増加により、車載用半導体（IGBT や MOSFET）の薄型化が急激に進むと予想される。しかし、高性能化を目的として薄型化されたウエハの取り扱いが反りや割れの発生といった問題があるだけでなく、ウエハが大口径化する動きもあり、扱いが一段と難しくなっている。そうしたなか各半導体メーカー並びに台湾や中国のファウンドリと呼ばれる半導体受託製造メーカーは、同社が独自技術で実現した「Supporter」を用いることで、生産プロセスにおける薄型のウエハの取り扱いが容易となる。

2. 沿革

同社は、電気機械器具の製造販売並びに電気機械器具の検査、測定、治工具及び金型の販売を目的として、1985 年 6 月に栃木県真岡市熊倉町で設立された。当初は三洋電機の半導体の後工程を担う三洋シリコン電子（株）の外販部門として後工程関係の設備を設計・販売していた。並行して社内で開発を進めてきた半導体やガラスなどの絶縁体の保持が可能な静電チャックの開発に目途が付いたことから、2002 年からは静電チャックの研究開発と静電チャック関連製品の販売に絞って事業を展開し、2018 年に東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場した。

同社の代表取締役社長である傅賣葉（ポー・フォライ）氏は東京大学大学院工学系研究科樋口研究室にて静電界形成技術（静電チャックの技術）を研究していた。当時の傅氏は同社から奨学金を得ており、卒業後すぐに同社に入社、以後も静電チャックの研究・開発を続け、同社をけん引している。

静電チャックの技術は、従来は吸着不可能とされてきた素材（半導体や絶縁体など）への吸着を可能としたが、当初はフラットパネルディスプレイのガラスの吸着テーブルなどに需要が限られていた。しかし 2010 年代に入り、EV 向けインバータの中心部品である次世代低抵抗 IGBT、5G 通信基地局向け半導体等のパワー半導体市場が拡大し、同市場向け半導体ではウエハ薄型化後の裏面のプロセスの安定化が重要な課題となった。「Supporter」は、ウエハ裏面プロセスにおいて、薄型ウエハを安定保持するためのウエハキャリアとして機能する。

会社概要

沿革

年月	事項
1985年 6月	栃木県真岡市熊倉町にて資本金 200 万円で株式会社設立
1988年 7月	栃木県真岡市松山町に移転
2002年 4月	静電チャックの設計販売開始
2003年 4月	液晶生産装置 ODF 向け G4、G5 基板対応静電チャックの設計販売開始
2004年 6月	ODF 向け G6、G7 基板対応静電チャックの設計販売開始
2006年 9月	本社を栃木県河内郡上三川町に移転 関東経済局より「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受ける
2007年 8月	ODF 向け G8 基板対応静電チャックの設計販売開始
2009年 4月	経済産業省の「2009 元気なモノ作り中小企業 300 社」に選定
2013年 6月	Carrier (キャリア) 型静電チャック「Supporter®」販売開始
2018年11月	東京証券取引所 TOKYO PRO Market に上場

出所：発行者情報よりフィスコ作成

事業概要

「ステージ」「Supporter」「自動機」の3製品を製造。 根幹技術は静電チャック

1. 主要事業

(1) 静電チャックとは

静電チャックとは、特定の素材基板（保持材）表面に電界を発生させることで、対象物（ガラスやシリコンウエハなど）を吸着保持する“治具（保持具）”のことである。対象物が非常に軽い・薄い素材の場合には割れやすく、あるいは反ってしまうことが多いため、長時間にわたって移動を繰り返すことは容易ではない。対象物が各種の製造プロセスを移動するような場合（例えばシリコンウエハなど）には、対象物を頑丈な治具に吸着保持させることで反りや割れといった損傷を防げる。

(2) 特色と強み

静電チャックの技術そのものは古くから存在し、様々な分野で使われているが、同社の静電チャックは以下のような特色がある。

1) 対象物が多様

同社の静電チャックの第一の特色は、対象物表面に電界を集中させることで、低電圧で高吸着力を発生させることにある。そのため、既存の静電チャックでは取り扱えなかったガラス・紙などの絶縁体の素材や極薄ウエハ等の半導体分野でも利用できる。

事業概要

2) 吸着力が均一で強い

電界の表面集中とイオン分極の最適化により、吸着が均一で吸着力が相対的に強い。この吸着力が均一であることが、下記に述べるように AI 半導体（正確には超微細化加工が必要な半導体）向けに評価されている。

3) 給電ユニットなしで吸着力を維持

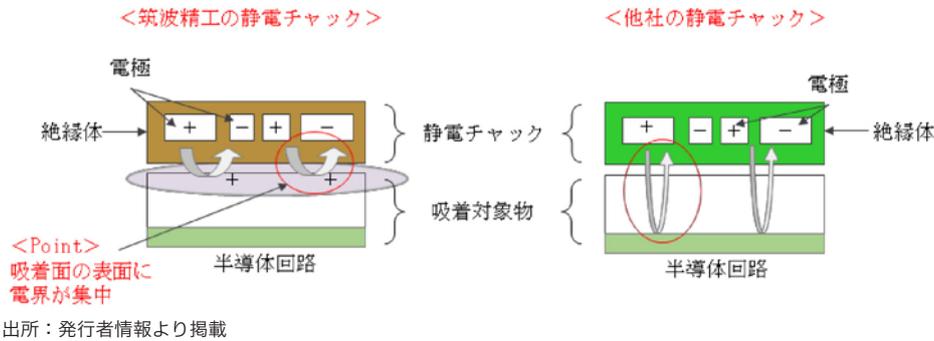
一般的な静電チャックが給電ユニットを常時接続して吸着力を維持するのに対して、同社の静電チャックは給電ユニットを外しても吸着力を維持できる点が特色である。また、回路形成後のシリコンウエハだけでなく、将来的にはパワー半導体等向けとして有望視されるガリウムひ素、チ化ガリウム、セラミック等にも応用可能になると見られる。なお、同社製品のなかで、給電ユニットなしでも吸着を維持できる製品は「Supporter」である。

同社製品と既存製品の特色比較 1

比較項目	同社の静電チャック	既存の静電チャック
静電チャックの基礎技術	独自で開発した電極と絶縁層の最適化設計技術により電界を吸着物の表面に集中発生させ、吸着物の表面を最大限にイオン分極させることで強い吸着力を得られる	電界の制御ができず、吸着物の表面に電界が集中しない。高電気抵抗体の吸着物の表面をイオン分極できないため吸着力が弱くなる
コードレスで薄い Carrier 型静電チャック	独自開発した電界の貯蔵技術で、吸着物吸着後、外部電源を外しても半永久に吸着力を維持できる。かつ、厚みが 0.5mm と薄く	対象物を分極吸着できる Carrier 型静電チャックはない
	既存設備の変更不要で極薄ウエハプロセスを可能にする	

出所：発行者情報よりフィスコ作成

同社製品と既存製品の特色比較 2



2. 製品別概要

従来は、主たる製品である「Supporter」及び「ステージ（ディスプレイ向け）」とそれ以外の「その他（ディスプレイ向け以外のステージ類似製品）」を製品別の区分としていたが、2024年3月期より給電ユニットから分離しても単体で稼働する静電チャックシステムの売上を「Supporter」、給電ユニットに常時接続して稼働する静電チャックシステムの売上を「ステージ」としている。また、今後は自動機ユニットの販売の重要性が増すと予想されたため、「自動機」の分類を新たに設けた。

筑波精工 | 2025年6月12日(木)

 6596 東証 TOKYO PRO Market | <https://tsukubaseiko.co.jp/ir/>

事業概要

(1) 「ステージ」

給電ユニットが付属している静電チャックを、“システム”として販売している。対象物の吸着 / 分離をコントロールできることから、薄いガラス板、スマートフォンのディスプレイ用フィルム、大型ディスプレイのODF（液晶滴下方式工法）向けとなっている。顧客は、スマートフォンを生産するメーカーに部品を納入しているメーカーや、大画面（2m × 2m など）の液晶ディスプレイを扱うメーカーなどである。

(2) 「Supporter」

主力製品である“静電チャック”の一種で、ガラスの両面に特殊な素材を挟みこみ一体形成したものである。同社既存の静電チャックが持つ特色に加え、給電ユニットから分離しても吸着力を維持する特色を備えている。給電ユニットを用いて一度電界をかけると保持力は半永久的に維持され、もう一度給電ユニットを用いて電界を解除すれば、いつでも「Supporter」と対象物を分離できるという従来の静電チャックにはなかった特色を有しており、“常識を打ち破った製品”と言える。「Supporter」は、半導体の製造プロセスでウエハの把持、運搬などに利用されるが、既存の製造ラインに大幅な修正を加えずに50 μ厚（μ = 1,000分の1mm）などの薄型ウエハの製造プロセスで発生するウエハの反りや微細なクラックによる不良品の発生を防止し、製造ラインの自動化率と製品の歩留率を向上させる。同製品の売上高は、主に「Supporter」の販売枚数 × 価格（非開示）である。

「Supporter」の特長を要約すると次のようになる。

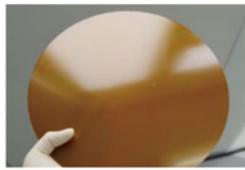
- ・ 0.5mm厚と薄いため、半導体ラインにそのまま投入可能
- ・ ウエハ吸着後も外部給電を必要としない
- ・ 給電ユニットから分離しても吸着力は半永久的に持続
- ・ 薄型ウエハの加工を可能とするほか、クラック等の発生を防止して歩留まりの向上を実現

(3) 「自動機」

「Supporter」に電界をかけて半導体製造ラインに自動投入するための機器を指す。2023年3月期までは試験用の半自動機であったが、2024年3月期に量産ライン用の「自動機」の販売を開始したため、新たな分類を設けた。

事業概要

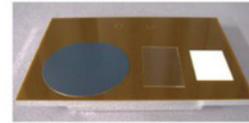
製品一覧



**Supporter (サポーター)
システム**



ESCステージ (生産設備向け)



コードレスホルダー



ハンディタイプ (ソフトバーム)

出所：同社ホームページより掲載



静電ベルト



ウエハーハンド

3. 半導体業界の動向

(1) 半導体製造プロセス

一般的にメーカーが半導体（ICチップ）を製造するプロセスは、まずシリコンインゴットを薄く切りウエハを作成する。この時点でウエハの厚さは約 700 μ あるが、この表面に真空蒸着、エッチング、アニーリング、スパッタリング、イオン注入などの方法で回路を形成する。パワー半導体に特徴的なプロセスとして、回路側の面に保護用のテープを貼付し、裏面を研磨して 100～150 μ まで薄くした後に、さらに裏面へのイオン注入やアニールなどの工程が必要となる。これらの工程を何度も繰り返してようやく 1 枚のウエハの回路作成が完了するため、回路作成には通常は 6～10 日ほど、複雑な回路では 1 ヶ月近くかかる場合もある。

この間、ウエハは真空状態や高温のプロセスなどを何度も繰り返し移動するが、裏面研磨後のウエハは非常に薄く、回路形成によるストレス蓄積等のため反りや割れといった損傷が発生しやすい。そのため回路生成プロセスにおいては、ウエハの表面（表面の回路が形成された面）に保持材を貼り補強してから裏面の回路形成プロセス間を移動させて、回路裏面の回路形成が終了した後、最終的にこの保持材を分離する。従来は、この裏面保持の方法として保持材を接着剤で貼り付けて補強するのが一般的であったが、今後自動車分野でのパワー半導体（IGBT 等）の需要が高まればウエハはさらなる薄型化と大口径化が進むと予想されている。接着剤方式では薄型化（100 μ 以下）と大口径化（12 インチ）への対応が難しいと業界では見られている。

筑波精工 | 2025年6月12日(木)

 6596 東証 TOKYO PRO Market | <https://tsukubaseiko.co.jp/ir/>

事業概要

(2) 自動車向け半導体

近年自動車のEV化が急速に進んでいる。自動車のEV化にとって重要な要素の1つが半導体の供給である。特に動力（パワー）部分では、バッテリーから出た電気（DC＝直流）をモーターで使用する交流（AC）に高速で変えるインバータが必須の部品となる。インバータ用の半導体（IGBT）では、径を大きくすることで1枚のウエハからより多くの半導体を作成できるため生産効率が上がり、1個当たりのコストを下げられる。しかし大容量（高アンペア）かつ高電圧（高ボルト）で表面と裏面の間でスイッチングを高速で繰り返すため、ウエハが厚い状態では発熱量※が増えることから、発熱の原因となるオン抵抗値をできる限り小さくするためウエハを薄型化する必要がある。半導体メーカーは、発熱量の点から半導体をできるだけ薄いウエハで生産し、かつ生産効率の点から大口径のウエハでの生産を目指している。

※インバータに使われるIGBTやMOSFETが発熱すると、EVのエネルギー効率が低下する。

(3) 半導体の薄型化と静電チャック

IGBTの生産プロセスでは、ウエハの薄型化がさらに進むという見方もある。さらに、多くのメーカーが生産効率の点から12インチ（300mm）ウエハへ移行する可能性が高い。その結果、ウエハはより薄く大きくなるため、反りや割れといった損壊のリスクが一段と高まる。それを避けるために保持材の貼付が必須となるが、従来の接着剤方式ではプロセスのなかで溶剤がガス化して半導体を汚染するリスクがある。また、保持剤を取り外す際にウエハが破損するリスクが高まるなど難点が多いと言われている。

そこで注目されているのが、同社が提供する静電チャック（方式）である。前述のとおり、同社の製品は一度電界をかけると半永久的に吸着保持を維持し、真空・高温などの環境下でも保持力が落ちないため、薄型化・大口径化されたウエハに対して最適な製品と言える。

(4) 半導体の微細化と静電チャック

もう1つの半導体業界の動向としては「微細化」が挙げられる。特にAI半導体などで超微細化が進んでいるが、現状ではプロセス装置や検査装置内のウエハ吸着固定による極微細な接触傷が歩留まりを低下させている。このため、キャリア（Carrier）でウエハをソフト吸着固定し、キャリアを固定することで間接的にウエハを固定する方法が歩留まり向上のために有効である。例えば5nmパターン以下では、「Supporter」（Carrier）を使えばウエハを全面でソフト吸着するため、ウエハ面積当たりに作用する吸着応力が大きく低下する。従来のメカクランプ等による集中応力によって起こされる局所的なウエハ接触傷を減らすことで、結果として歩留まりの向上につながる。その上、「Supporter」吸着面は半導体ウエハに比べて柔らかいPI樹脂で形成されているため、相対的に硬い半導体ウエハ面を傷付けにくい。

EV向け半導体では、「ウエハの薄型化」が命題であったが、AI半導体向けでは「接触傷の減少による歩留まり向上」として、大手ファウンドリから注目され始めている。

事業概要

4. 主な顧客と需要

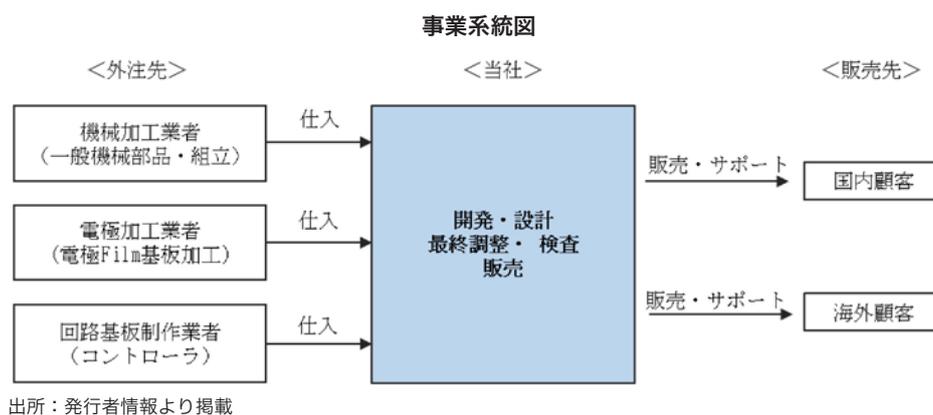
同社の主力製品である「Supporter」の主要顧客は半導体のデバイスメーカーである。需要は、生産される半導体の数（ウエハの枚数）に比例する。「Supporter」は1枚のウエハが一通りのプロセスを終了した後、ウエハから外し洗浄してから繰り返し利用できる。したがって、仮に一通りのプロセスを終了するのに6日かかるとすると、1枚の「Supporter」は月に5回利用できるため、ウエハの生産能力の5分の1の枚数が必要になる（例：ウエハ生産能力が5万枚/月であれば、1万枚の「Supporter」が必要）。なお、「Supporter」の絶対寿命は約2年間である。

同社の主要顧客については開示されていないが、同社によるとIGBTの表面パターン（回路生成）に関連した特許は米国と日本に多く、この分野では中国が遅れている。そのため中国は表面プロセスではなく、薄型化の分野（裏面プロセス）へ積極的に投資を行っており、同社の主要顧客も中国や台湾メーカーが多いようだ。参考として、同社公開資料「中間発行者情報」に記載された2025年3月期第2四半期の販売先別実績の上位は、Suzhou Dongwu Precision Technology Co., Ltd.（中国）、売上高25百万円（売上高比率21.8%）となっている。

5. 同社の生産能力と特許政策及び競合

同社製品の生産については、一部を内製し、その他の部分を数ヶ所に分けて外注する「ファブライト」方式を採用している。このため外注先は最終的にどのような製品になるかはわからない。また需要が急増した場合でも、大型の生産設備を必要とする製品ではないため、同社は「生産が間に合わない事態にはならない」と説明している。

特許についても、外注の分散と同様に秘匿性を高める策を講じている。同社は数多くの特許を保有しているが、すべての技術・ノウハウを特許申請しているわけではない。申請をしていない技術の詳細は不明であり、競合会社が同社の技術を盗用して類似製品を製造することは難しい。



■ 業績動向

2025 年 3 月期は EV 向けが停滞し、営業損失を計上。 ただし、期末にかけて回復の気配

1. 2025 年 3 月期の業績概要

2025 年 3 月期の業績は、売上高は 237 百万円（前期比 27.2% 減）、営業損失 44 百万円（前期は 6 百万円の損失）、経常損失 45 百万円（同 7 百万円の損失）、当期純損失 69 百万円（同 30 百万円の利益）※となった。期待されていた EV 市場が予想に反して停滞したことから同社の主要顧客（半導体メーカー）が設備投資を抑制し減収となり、営業損失を計上した。ただし、期末にかけては回復傾向も見られた。

※ 前期は、デモ用機器の販売により特別利益 59 百万円を計上したことにより当期純利益を計上した。

製品別売上高は、「ステージ」が 180 百万円（前期比 33.1% 増）、「Supporter」が 57 百万円（同 44.1% 減）、「自動機」は売上の計上なし（前期実績 88 百万円）であった。「ステージ」については、2024 年 4 月に中国半導体装置メーカーと販売契約を受注したことによる影響もあり前期比では増収となった。「Supporter」は、EV 市場の低迷で顧客の生産が期待されたほど立ち上がり減収となった。

2025 年 3 月期の業績

（単位：百万円）

	24/3 期		25/3 期		前年比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
売上高	326	100.0%	237	100.0%	-89	-27.2%
ステージ	135	41.6%	180	76.0%	44	33.1%
Supporter	102	31.3%	57	24.0%	-45	-44.1%
自動機	88	27.1%	-	-	-88	-
売上総利益	168	51.5%	133	56.1%	-34	-20.8%
販管費	174	53.5%	177	74.7%	3	1.8%
営業利益	-6	-	-44	-	-38	-
経常利益	-7	-	-45	-	-37	-
当期純利益	30	-	-69	-	-99	-

出所：決算短信よりフィスコ作成

自己資本比率は56.2%、現金及び預金は352百万円で 財務上の懸念はないが、今後の動向は要注視

2. 財務状況

2025年3月期末の資産合計は前期末比115百万円減の332百万円となった。流動資産は同115百万円減の329百万円となった。主に現金及び預金の減少73百万円、売掛債権の減少1百万円、棚卸資産の減少10百万円による。固定資産は、同0.5百万円減の3百万円であった。

流動負債は同36百万円減の51百万円となった。主に仕入債務の減少25百万円、前受金の減少6百万円による。固定負債は同9百万円減の94百万円となったが、主に長期借入金の減少12百万円による。その結果、負債合計は同45百万円減の145百万円となった。

純資産合計は同69百万円減の186百万円となった。当期純損失の計上などによる利益剰余金の減少69百万円による。その結果、2025年3月期末の自己資本比率は56.2%（前期末57.2%）となった。また、手元の現金及び預金は278百万円で、現時点では問題は水準だが、今後も損失計上が続くようであれば、債務超過の懸念も出てくるので、今後の財務状況は注視する必要がある。

2025年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは58百万円の支出となった。主な収入は減損損失13百万円、棚卸資産の減少10百万円などで、主な支出は税引前当期純損失67百万円、売上債権の増加5百万円、仕入債務の減少25百万円等であった。投資活動によるキャッシュ・フローは1百万円の支出となったが、有形固定資産の売却による収入15百万円及び有形固定資産の取得による支出17百万円による。財務活動によるキャッシュ・フローは長期借入金の返済により3百万円の支出となった。

この結果、期中に現金及び現金同等物は73百万円減少し、現金及び現金同等物の期末残高は218百万円となった。

業績動向

貸借対照表

(単位：百万円)

	24/3 期末	25/3 期末	増減額
流動資産	445	329	-115
現金及び預金	352	278	-73
売掛債権（電子記録債権含む）	17	16	-1
棚卸資産	29	18	-10
固定資産	3	3	-0
資産合計	448	332	-115
流動負債	87	51	-36
仕入債務（電子記録債務含む）	36	11	-25
前受金	8	2	-6
固定負債	104	94	-9
長期借入金	103	90	2
負債合計	191	145	-45
純資産合計	256	186	-69

出所：決算短信よりフィスコ作成

キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	24/3 期	25/3 期
営業活動によるキャッシュ・フロー	-68	-58
投資活動によるキャッシュ・フロー	25	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3	-13
現金及び現金同等物の増減額	-46	-73
現金及び現金同等物の期末残高	292	218

出所：決算短信よりフィスコ作成

■ 今後の見通し

2026 年 3 月期は営業黒字を目指す。 EV 向け回復に加えて AI 半導体向けに期待

2026 年 3 月期の業績は、売上高は 351 百万円（前期比 47.8 増）、営業利益 4 百万円（前期は 44 百万円の損失）、経常利益 3 百万円（同 45 百万円の損失）、当期純利益 1 百万円（同 69 百万円の損失）と予想している。

今後の見通し

2026年3月期の業績見通し

(単位：百万円)

	25/3 期		26/3 期		前年比	
	実績	構成比	予想	構成比	増減額	増減率
売上高	237	100.0%	351	100.0%	113	47.8%
営業利益	-44	-	4	1.1%	48	-
経常利益	-45	-	3	0.9%	48	-
当期純利益	-69	-	1	0.3%	70	-

出所：決算短信よりフィスコ作成

製品別の売上高予想は開示されていないが、各製品とも増加を見込んでいる。1つ目の要因は、EV向けに回復が見られることで、既に2025年4月に「Supporter」と「自動機」で約59百万円を受注している。今後、生産が増加するに伴い「Supporter」売上が増加すると推測される。また既述のように2025年3月に特定プロセス向けに「ステージ」を受注済みで、こちらも採用が拡大する可能性が高い。

さらに2026年3月期はAI半導体向けの立ち上がりが期待できそうだ。同社によれば、既に2024年夏から海外の大手ファウンドリとテストを繰り返しており、期中に「流し込みライン」(テスト用ライン)向けに「自動機」と「Supporter」合わせて約90百万円を受注を期待できるとのことである。

■ 中長期の展望

EV車の課題は「航続距離」、AI半導体の歩留まり向上には「Supporter」が有効

1. EV車の今後の課題(航続距離)と解決策

過去数年間、中国と欧米を中心に自動車のEV化は加速度的に進んだが、足元ではその伸び率が鈍化している。ここで指摘されている課題の1つが「航続距離」、すなわち1回の充電で走行できる距離が短いことだ。特に冬場は、より多くの電気を暖房用に消費するため、充電ステーションに長蛇の列ができています。これが最近の「EV離れ」の要因の1つとなっている。

(1) 航続距離が短い主要因はインバータの発熱

一般的なEV車(大衆車)の航続距離が短い主要因は、インバータの発熱にある。EV車では、バッテリーのDC電力をACに変換しモーターを回すが、この役割を果たすのがインバータで、変換時の発熱が電力損失を生んでいる。今後EV車の航続距離を伸ばすためには、インバータでの電力損失を極力抑えることが必須条件となる。

(2) 2つの解決策：SiC 基板か極薄 Si 基板

同社によれば、このインバータでの熱損失を抑える方法は、現時点においては主に2つあるとのこと。1つはSiC（シリコンカーバイド）基板を使うことだが、SiC 基板は量的な供給が限られていることから非常に高額であり、限られた一部の高級車にのみ搭載できる。一般大衆車への搭載はコスト面から難しい。

一方でSi基板（通常のシリコンウエハ）は安価で大量供給が可能だが、熱損失を抑えるためには厚みを80 μ m 厚（可能なら60 μ m 厚）以下にする必要がある。しかし量産ラインにおいては80 μ m 厚以下のウエハの取り扱いが非常に難しく、通常の「接着剤方式」が使えないため、同社の「静電チャック方式」が必要となる。

注：上記は取材に基づいた同社の説明による。

2. 潜在市場の推測

上記のような事業環境から、同社の先行きには楽しみもあるが、ウエハの薄型化が進むためには乗り越えるべき課題・壁も多い。当初、同社によるとEV向けにウエハの薄型化が進むのは2024年3月期以降としていたが、実際は2～3年ほど遅れる気配である。したがって、同社の業績が本格的に浮上するのも2027年3月期からと予想される。

今後、潜在的な市場はどの程度あるのか、同社の説明によると、従来、薄型IGBT生産の主力は6インチウエハであったが、2023年秋から8インチウエハで80 μ mが本格的に稼働し、一部では12インチが立ち上がりつつあるようだ。12インチウエハ1枚からは自動車約3台分のIGBTが取れると言う。したがって今後のEV自動車生産予測から、同社では12インチウエハ用「Supporter」の需要については、遅くとも2027年3月期に7,000枚/年になると見ているようだ。

「Supporter」の価格は正式には開示されていないが、取材に対して同社は「12インチウエハ用で1枚数千米ドルのレベル」と述べている。仮にこの価格を3千米ドル、1米ドルを150円とすると、2027年3月期の「Supporter」の売上高は、 $7,000 \times 3,000 \times 150 = 3,150$ 百万円※となる可能性がある。

※ これらの数字は弊社推測によるもので、同社から正式に発表された数字ではない。

同社によれば、既に12インチ月産15万枚を準備している顧客がいるとのこと、事実2024年3月期には12インチ量産用の「自動機」を販売した。同社では12インチの保持材について、今のところ「Supporter」に対して競合する製品はないと見ている。今後は8インチでの同社製品の採用増とともに、12インチへの展開も注視する必要がある。

3. もう 1 つの潜在市場 (MOSFET 用) と IGBT の広がり

同社製品 (主に「Supporter」) に対して、もう 1 つ大きな市場として期待されるのが MOSFET 用だ。現在、自動車用と携帯電話用バッテリーの大容量化が進んでおり、これらのバッテリーにおいては高速 (短時間) での充電が求められている。そのためには、高電圧をかける必要があり、これに耐えられる MOSFET 半導体が必要部品となる。MOSFET 半導体の厚さは約 100 μ であるが、デバイスメーカーとしては少しでも生産効率を上げるために 8 インチウエハでの生産を標準としている。その生産工程ではウエハの「反り」が大きな問題となるが、これに対応できるのが同社の「Supporter」である。

同社では MOSFET 用としての「Supporter」の需要も今後増えていくと見ており、IGBT 用と並んで楽しい市場である。MOSFET 用 (8 インチ用) の価格は、IGBT 用 (12 インチ用) よりは低いと予想されるが、将来の売上高は年間 200 ~ 300 百万円に上る可能性があると思われ、弊社では見ている。

また最近では、薄型 IGBT 市場が広がってきている点も注目だ。現在、最も需要が期待されているのが EV 自動車なのは言うまでもないが、近年では風力発電用、家電用にも需要が広がっている。

4. AI 半導体向け

さらに今後期待できる市場が AI 半導体向け、正確に言えば「超微細化の半導体向け」である。AI 半導体などでは超微細化が進んでいるが、現状ではプロセス装置や検査装置内のウエハ吸着固定による極微細な接触傷が歩留まりを大きく低下させており、これを改善するために、同社の「Supporter」(Carrier) の採用が検討されている。

既に海外大手のファウンドリ向けにテストライン用の受注が見込めるようだが、量産ラインに採用されれば大きな受注が期待できる。EV 向けに加えて、今後は AI 半導体向けも注視する必要がある。

■ 株主還元策

まずは安定した業績確保が先決

同社はまだ発展途上の企業であり十分な利益を確保できていない。株主還元はまだ先の話であり、まずは足元の利益をしっかりと確保することが先決だろう。

重要事項（ディスクレマー）

株式会社フィスコ（以下「フィスコ」という）は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。

本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したのですが、フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかんを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業への電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受けて作成されていますが、本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは堅く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

■お問い合わせ■

〒107-0062 東京都港区南青山 5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443（IR コンサルティング事業本部）

メールアドレス：support@fisco.co.jp